

주주총회소집공고

2015년 3월 12일

회 사 명 : 아이원스 주식회사
대 표 이 사 : 이 문 기
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄지성로412번길30-5
(전 화)031-238-7785
(홈페이지)<http://www.iones.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책)CFO (성 명)서혁
(전 화)031-238-7785

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제23조의 규정에 의하여 제10기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2015년 3월 30일 월요일 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 행정리327번지 화성상공회의소 4층 컨벤션홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 10기(2014.1.1-2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
승인의 건

※ 배당금(예정) : 1주당 배당금 50원(액면가 10%)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지(www.ion
es.co.kr)에 게재하고 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니
참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니
다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필

요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
주주인감 날인 및 인감증명서 첨부, 대리인의 신분증)

7. 기타사항

- 제10기 배당은 보통주 1주당 50원 현금배당을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2015년 03월 12일

경기도 화성시 동탄지성로412번길 30-5

아이원스 주식회사

대표이사 이 문 기 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차 (2014년)	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명		
			임윤태	장영수	이운상
			A (출석률: 57%)	B (출석률: 86%)	C (출석률: 7%)
			찬 반 여부		
1	2014-02-18	2013년 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-
2	2014-02-18	2013년도 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	찬성	찬성	-
3	2014-02-19	제9기 현금배당 결정의 건	찬성	찬성	-
4	2014-03-06	제9기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-
5	2014-03-12	지점 설치의 건	-	찬성	-
6	2014-03-28	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성
7	2014-04-24	신규 운영자금 차입의 건	-	찬성	-
8	2014-07-21	지점이전 및 지정명칭변경의건	-	찬성	-
9	2014-07-21	신규 운영자금 차입의 건	-	찬성	-
10	2014-07-21	씨티은행 기채 및 은행여신에 관한 건	-	찬성	-
11	2014-09-05	신규 시설 투자의 건	찬성	-	-
12	2014-10-06	신규 운영자금 차입의 건	찬성	-	-
13	2014-11-12	제10기 임시 주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-
14	2014-12-11	기업운전일반기금대출 신청의 건	-	찬성	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
	임윤태	2014-01-24	경력사원 경업금지위배의 건	가결
		2014-02-28	경력사원 경업금지위배의 건	가결
		2014-03-28	경력사원 경업금지위배의 건	가결
		2014-04-25	경력사원 경업금지위배의 건	가결
		2014-05-30	경력사원 경업금지위배의 건	가결
		2014-06-27	경력사원 경업금지위배의 건	가결

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
법무위원회	장영수 이윤상	2014-07-25	경력사원 경업금지위배의 건	가결
		2014-08-29	경력사원 경업금지위배의 건	가결
		2014-09-26	경력사원 경업금지위배의 건	가결
		2014-10-31	경력사원 경업금지위배의 건	가결
		2014-11-28	경력사원 경업금지위배의 건	가결
		2014-12-27	경력사원 경업금지위배의 건	가결
감사위원회	장영수 임윤태 이윤상	2014-02-13	2013년 실적보고의 건	가결
		2014-04-30	2014년 1분기 실적보고의 건	가결
		2014-07-31	2014년 2분기 실적보고의 건	가결
		2014-10-31	2014년 3분기 실적보고의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	3	11억원 (이사보수 총액)	54,000,000	1,500,000	-

상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 전체 이사(총 6명)에 대한 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 2014년 1월~ 12월까지의 누계 지급기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 주요 사업은 반도체 전공정 장비 부품의 정밀 가공 및 세정, 디스플레이 제조 장비 부품의 정밀 가공, 디스플레이 장비 제조를 주요사업으로 하고 있습니다. 당사는 반도체 및 디스플레이 정밀가공 부품 제조사업을 근간으로 영위하는 회사로서 사업의 다각화 및 매출의 다변화를 위하여 지속적인 투자 및 연구개발을 토대로 그린사업인 환경사업, LED사업, 특화된 해외 및 특수 사업부(펌프, 항공, 국방) 등의 확대를 통한 사업 포트폴리오의 구축과, 정밀가공부품 기술을 기반으로 관련 사업을 유기적으로 연계시켜 발전하여 왔습니다. 당사가 영위하는 주요 사업을 사업특성으로 분류하면 다음과 같습니다.

구 분	주요내용
초정밀 가공 사업	1) 반도체, 디스플레이 전공정 장비에 사용되는 정밀부품의 제작 및 국산화 2) 항공/국방산업에 사용되는 정밀 가공부품의 제작 3) TFT-LCD 및 모바일 기기 제조 공정 장비 개발
초정밀 세정 사업	1) 반도체 전공정 장비에 사용되는 소모성 부품의 초정밀 세정 2) 반도체 전공정 장비에 사용되는 소모성 부품의 초정밀 코팅
기타사업	1) 반도체, 디스플레이 제조공정 클린룸에 사용되는 고효율 CAF(Chemical Air Filter) 2) LED 조명 완제품 생산

주) 상기의 사업구분은 이해를 돕기위한 기능별 분류로서, 당사의 실제 사업부별 구분과는 다릅니다.

가. 업계의 현황

(1) 반도체 사업

국내의 반도체 산업은 1983년 메모리공정 사업에 국내기업이 본격적으로 참여하면

서 급속한 발전을 이룩해왔습니다. 짧은 기간에도 불구하고 현재 우리나라는 세계 1위의 반도체 생산대국으로 성장했습니다. 특히 DRAM분야를 축으로 하는 반도체 메모리분야에서는 공급능력이나 공정기술 그리고 가격 및 품질 면에서 세계최고의 경쟁력을 보유하고 있으며 단일품목으로 볼 때 1992년 이래로 10년 연속 수출 1위 품목으로 우리 경제의 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 반도체 산업이 성장, 발전하기 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등 다양한 학문적 기초를 필요로 하며, 초미세, 고집적, 극저온, 고진공 등을 구현하기 위한 높은 기술이 필요한 기술집약적 산업이며, 거대한 투자를 바탕으로 한 공정라인 구축, 생산공정을 위한 대규모의 자본이 투하되는 대표적인 자본집약적 산업입니다.

반도체는 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 논리적인 정보처리와 제어 기능을 수행하는 비메모리 반도체로 구분되며 비메모리 반도체가 메모리 반도체보다 3~4배 큰 시장을 형성하고 있습니다. 최근 증가속도는 메모리 반도체가 비메모리 반도체를 능가하는 추세로 컴퓨터 기능이 가미된 이동통신기기의 등장으로 모바일 기기에서 저장장치 역할을 하는 NAND Flash Memory등이 빠른 속도로 증가되고 있으며 이에 대한 세계 반도체 시장의 매출구조는 아래와 같습니다.

메모리 반도체 시장 전망



D램 시장 전망



낸드플래시 시장 전망
(출처 : 디지털타임스 2015년 1월)

2014년 전세계 매출별 상위 10개 반도체 공급업체

(단위: 백만달러)

2013년 순위	2014년 순위	공급업체	2013년 매출	2014년 잠정매출	2014년 시장 점유율(%)
1	1	인텔(Intel)	48,590	50,840	15.0
2	2	삼성전자	30,636	35,275	10.4
3	3	퀄컴(Qualcomm)	17,211	19,194	5.6
5	4	마이크론(Micron)	11,918	16,800	4.9
4	5	SK하이닉스	12,625	15,915	4.7
6	6	도시바(Toshiba)	11,277	11,589	3.4
7	7	텍사스 인스트루먼트 (Texas Instruments)	10,591	11,539	3.4
8	8	브로드컴(Broadcom)	8,199	8,360	2.5
9	9	ST마이크로일렉트로닉스	8,082	7,371	2.2

2013년 순위	2014년 순위	공급업체	2013년 매출	2014년 잠정매출	2014년 시장 점유율(%)
		(STMicroelectronics)			
10	10	르네사스 전자 (Renesas Electronics)	7,979	7,249	2.1
기타업체			147,883	155,679	45.8
총 합계			314,991	339,811	100

(출처: 가트너 2014년 12월)

(2) 디스플레이 산업

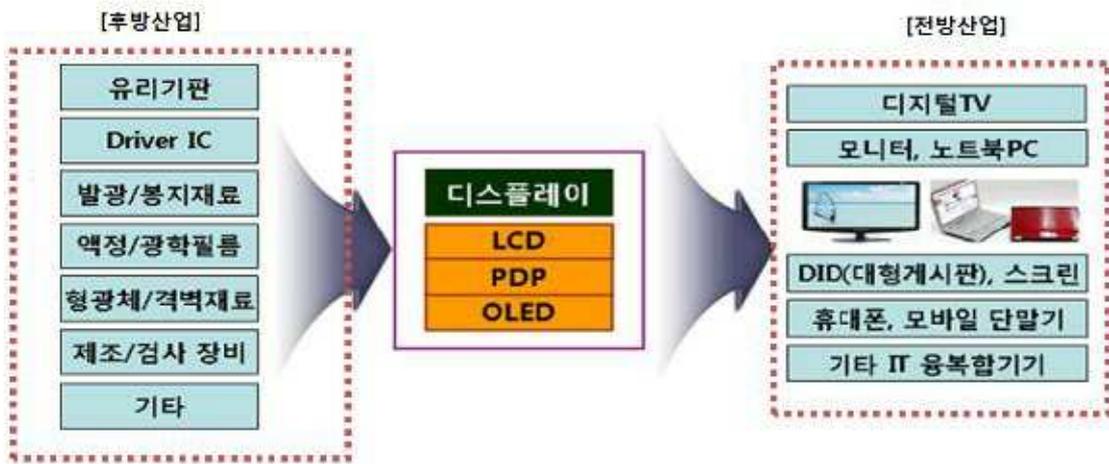
디스플레이 산업은 휴대폰, 노트북, 모니터, TV 등 평면 표시장치 (LCD, PDP, OLED)를 생산하는 산업부문을 의미하며 평판 디스플레이라는 명칭으로 대표되고 있습니다. 디스플레이 장치는 액정 표시장치의 종류와 규격에 맞게 우리의 일상생활에 폭 넓게 사용되고 있으며, 대표적인 주요 수요제품의 현황은 아래와 같습니다.

디스플레이 장치의 대표 수요제품

디바이스	구분	대표적 수요제품
LCD	중소형 제품	휴대폰, 디지털카메라, 디지털캠코더, 차량용 네비게이션 등
	대형 제품	노트북, 디지털TV, 모니터, DID (전광판, 광고판) 등
PDP		디지털TV
OLED	수동형 (PM)	게임기, 카오디오, PMP, 백색가전 등
	능동형 (AM)	스마트폰, 스마트패드, 고화질TV

디스플레이 산업은 대표적인 장비 및 부품산업으로서 전방산업과 후방산업의 영향을 크게 받기 때문에 전후방 연관 산업의 네트워크 구축이 매우 중요합니다. 패널은 전방산업인 TV, 모니터, 노트북, 스마트폰 등의 멀티미디어제품 등의 성장(시장성)과 밀접한 관계에 있으며 후방산업인 패널 생산 장비의 주요 부품과 소재는 조달능력(생산성, 공급망)과 기술력이 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다. 당사는 패널 생산업

체 및 Global 장비제조 업체에 다년간 축적된 핵심부품 설계기술과 초정밀 가공기술을 바탕으로 디스플레이 산업 전반의 장비제조, 부품공급 및 핵심부품 국산화 개발에 참여하고 있습니다.



디스플레이의 종류 및 전후방 연관산업

[출처: 산업연구원 디스플레이 산업전망]

스마트폰 개발 이전의 디스플레이 산업 발전 과정은 주요 수요 제품들의 빠른 세대교체를 이끄는 계기가 되었지만 스마트폰으로 대표되는 멀티미디어제품과 고화질 디스플레이에 대한 수요증가는 디스플레이 산업을 새로운 시대로 변화시키고 있습니다. 디스플레이 산업 초기 시장을 선점했던 PDP는 브라운관 TV를 디지털 TV로 전환을 주도했고 대면적 유리기판의 생산은 LCD의 약진을 통해 노트북과 모니터, 대형 TV를 보편화 시켰으며 최근 선풍적인 인기를 끌고 있는 스마트폰과 태블릿 PC, 고화질 3D TV의 수요는 OLED의 급속한 성장으로 연결되어 수요제품과 산업 발전이 상호 보완하며 꾸준한 성장을 이루게 되었습니다. 이와 같은 시장의 변화는 완성 제품의 수요 추세를 IT 기계에서 가전제품의 변화로 자연스럽게 전환하는 계기가 되었습니다.

스마트폰 시장은 선진국 시장을 중심으로 400달러 이상의 하이엔드제품이 주류였으나, 신흥국시장을 겨냥해서 개발된 200달러 미만의 저가품 출하가 급증하는 추세입니다. 특히 중국에서는 '1000원 스마트폰'(약160달러)라 불리는 저가격 스마트폰이

등장해 이 분야의 신흥메이커 출하 대수가 급증하였습니다.

2014년 스마트폰 판매량에서 Lenovo, Huawei, Xiaomi가 나란히 3~5위를 차지하였으며, 특히 중국에서 저가 스마트폰으로 돌풍을 일으킨 Xiaomi의 약진은 놀랍습니다. 중국의 스마트폰 시장 규모는 2012년 이미 미국을 제치고 세계 1위 수준으로 도약했으며, 향후에도 중국의 경제성장으로 인한 자국민들의 생활수준 향상으로 시장 규모는 더욱 확대될 전망입니다.

2014년 전세계 제조사별 스마트폰 출하량 (단위:백만대)

업체	2014	14.4Q	2013	13.4Q
Samsung	318.2	75.1	319.8	84.4
Apple	192.7	74.5	153.4	51.0
Lenovo- Motorola	96.5	24.7	62.1	19.5
Huawei	73.6	23.5	50.4	16.6
기타	620.1	177.4	433.7	121.2
합계	1,301.10	375.20	1,019.40	292.70

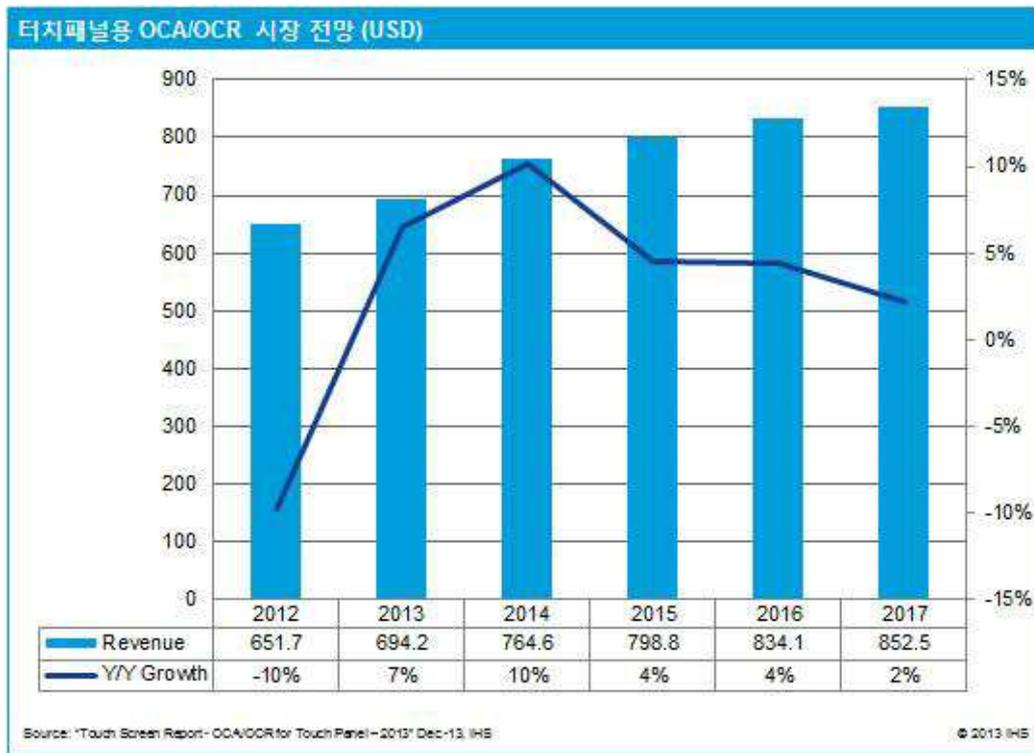
[출처:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, January 29, 2015]

2014년 중국 제조사별 스마트폰 출하량 (단위:백만대)

업체	2011	2012	2013	2014
Samsung	10.9	30.6	62.5	58.5
Xiaomi	0.4	5.7	18.6	57.8
Lenovo	3.5	22.9	42.1	45.1
Huawei	7.2	17.1	33.6	41.3
Apple	10.8	19.1	20	31.1
기타	54.8	78	140.3	189.8
합계	87.60	173.40	317.10	423.60

[출처:Strategynalytics, Mar 2, 2015]

사용자들이 스마트폰을 실내 뿐 아니라 이동하면서도 늘 사용하면서, 스마트폰 구매 시 소비자들의 구매 결정 요인 중 Display도 더욱 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 시장조사업체 IHS는 터치패널 부재간 접착 및 에어갭을 없애는 데 사용되는 OCA/O CR 시장 규모는 2013년 6억 9400만 달러 규모에서 2017년에는 8억 5200만 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다고 발표한 바 있습니다. 이는 Display의 시안성과 양산화의 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 터치패널용 본딩장비 시장과 수요 확대에 의한 당사의 전망을 밝게 하고 있습니다.



터치패널용 OCA/OCR 대수 시장 전망

[출처:Touch Screen Report-OCA/OCR for Touch Panel-,DEC, 2013,IHS]

(3) 부품산업 현황

세계 반도체 장비 시장 매출은 2011년 443억 3000만 달러 규모였습니다. 당시 전년 대비 148% 늘어난 고무적인 성장세를 보였으나, 이 후 투자가 급감해 2012년 369억

달러, 2013년 318억 달러로 줄었습니다. 2014년은 380억 달러 시장을 형성할 것으로 예측했으며 성장세를 지속해 2016년에는 2015년과 비슷한 436억 달러가 될 것으로 국제반도체장비재료협회(SEMI)는 분석했습니다.

SEMI는 장비당 가격이 가장 높은 웨이퍼 처리 장비 시장이 전년대비 17.8% 성장해 2014년 299억 달러를 형성한 것으로 분석했습니다. 어셈블리와 패키징 장비는 30.6% 성장한 30억 달러, 반도체 테스트 장비는 26.5% 증가한 34억달러 규모를 형성한 것으로 분석했습니다.

한편, 2015년에 가장 많은 장비 투자를 집행할 지역으로 유럽,대만,한국을 꼽았습니다. 유럽은 전년대비 47.9% 늘어난 39억 달러 규모 장비를, 대만은 28.1% 늘어난 123억 달러 규모 장비를, 한국은 25% 성장한 80억 달러를 장비 구매에 사용할 것으로 예측하고 있습니다.

이와 관련하여 삼성전자가 2017년 하반기를 목표로 평택 산업단지에 15.6조원을 투자하기로 발표하였고, 하이닉스도 경기 이천에 D램 생산을 위한 신규라인 (M14라인)을 짓는 등 총 5조원 이상을 투자할 방침입니다. 이러한 국내 반도체 제조사들의 지속적인 시장확대 및 수율 개선 노력에 힘입어, 직접적으로 국내 반도체 장비 업체 및 반도체 부품 업체의 수혜가 예상되고 있습니다.

SEMI® 2014 Year-End Equipment Forecast by Market Region



Source: SEMI; December 2014

Totals may not add due to rounding

반도체 부품 세정/코팅시장은 1997년 이후 원가절감의 일환으로 반도체 공정 장비 내에 조립되는 고가의 소모성부품들을 교체하여 사용하던 것을 반도체 업체 자체적으로 세정하여 사용하기 시작하였으며, 최근 몇 년 사이 자체 세정하던 물량을 생산 Capa 증대 등으로 전량 외주세정(당사가 진행하고 있는 형태의 세정)으로 전환하게 되었습니다. 2010년 이후 반도체 생산량을 늘리기 위해 삼성전자 내부에 세정장비 공간을 없애고 생산공정 장비를 설치하면서 외주세정 의존도가 높아지고 이에 따른 외주세정시장이 성장하고 있습니다. 따라서 기존 자체 세정 물량을 전량 외주처리로 전환하게 되어 세정시장이 성장하고 있습니다. 반도체 산업에 끊임없는 신기술 개발로 향후 반도체 시장은 450mm FAB(Fabrication Facility) 과 20나노급 공정이 진행될 것으로 보이며 이에 따른 당사의 부품세정 코팅시장은 지속적으로 성장할 것으로 보고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 사업군 중 상기의 반도체, 디스플레이 산업과 연관이 있는 분야는 1) 초정밀 부품가공, 2) 초정밀 세정, 3) 기타사업 부문입니다.

1) 초정밀 가공 사업

당사가 영위하는 초정밀 가공 사업은 크게 반도체, 디스플레이 제조 공정에 사용되는 초정밀 가공 부품을 생산/제작 하는 사업으로 아래와 같은 주요 영역으로 나눌수 있습니다.

구분	내용	주요 매출처
초정밀가공 사업	1) 반도체, 디스플레이 제조 공정에 사용되는 장비 부품의 제작 2) 반도체 장비 개조개선에 따른 부품 제작	삼성전자, LG디스플레이
	1) 반도체 장비 국산화 프로젝트에 따른 장비 부품 국산화 제작	SEMES 등

반도체 제조 공정 장비는 해외 장비 제조사의 수입의존도가 높고 소모성 부품도 해외 원장비 제작업자로부터 구매하는 경우 고가이므로 반도체 업체의 원가경쟁력 확보에 어려움이 있습니다. 당사의 이에 대한 문제점을 인식하고 부품 계측 분석 및 정밀 가공 기술을 바탕으로 부품을 국산화하여 동일한 품질의 부품을 저가로 공급하여 수입 대체함에 따라 반도체 소자업체의 원가경쟁력에 기여하고 있습니다. 당사가 영위하는 반도체 제조 공정 부품 정밀 가공사업은 반도체 산업 전반의 경기와 그 맥을 같이 하고 있으며 반도체 업체의 가동률 즉, 반도체 생산량과 깊은 연관을 가지고 있습니다. 가공부품은 가동을 많이 하면 할수록 대상 부품의 교체 주기가 단축되기 때문에 당사의 매출도 이에 연동되고 있습니다.

반도체 부품 시장은 경기가 악화되면 수입에 의존하던 장비부품을 국산화로 대체하고, 신규장비 구입보다는 기존 장비 성능향상을 위한 개조개선투자 시장이 확대됩니다. 반도체 기술의 발전 속도 및 반도체의 세대교체가 주기적으로 진행되므로 장비의 평균 기술 수명은 약 5년 정도지만, 부품 라이프타임(Lifetime)이 짧은 특성이 있어 지속적인 공급이 필요한 고부가가치 산업입니다. 당사는 1994년 삼성전자 협력업체 등록 후 Shower head / Manifold 등 2,000여종의 부품을 국산화하여 공급하고 있으며, 2010년 삼성전자 자회사인 SEMES社(전 GES社)와 부품공급 정식 계약을 맺었습니다. 또한 2011년 6월 삼성전자(주) 부품국산화를 주관하는 생산기술연구원의 부품공급업체로 등록되었고, 2012년 3월에는 삼성전자의 대표적인 장비업체인 A社와 정식 협력업체 등록을 해 개조개선투자 및 국산 신규 장비 개발에 주력하고 있습니다. 현재 당사는 기술을 접목한 영업활동을 통해 반도체장비 신규/개조개선투자 업무 진행 및 국내외 메인장비 업체들과 지속적인 교류를 통해 사업 확대를 추진하고 있습니다.

당사의 디스플레이 사업부문은 반도체 사업부문과 더불어 당사의 핵심 사업부문으로 당사의 핵심기술인 정밀 가공 기술을 바탕으로 한 LCD, Solar Cell 생산에 필요한

모든 공정의 핵심부품을 국산화하여 공급하고 있습니다. 당사는 3,000여종의 디스플레이 및 반도체 부품 가공기술 Know-How와 진공장비 부품 국산화 및 가공 기술력을 바탕으로 납기의 단축 및 원가절감을 실현하고 있어 고객사인 삼성전자, 삼성디스플레이, 엘지디스플레이 등의 제품 경쟁력에 일조하고 있습니다.

당사의 정밀가공 사업 중 디스플레이관련 부품소재 사업은 2가지 CASE로 진행되고 있습니다. ㉠ 국내외의 패널 생산업체에 부품공급 ㉡ 국내외 패널 생산용 장비 업체 부품 공급입니다. 당사는 국내의 대표적인 패널업체(삼성, 엘지디스플레이)의 핵심협력사로 선정되어 부품개발 공급 및 고가의 외산부품 국산화개발을 통해 고객사의 원가절감에 기여하고 있습니다.

디스플레이 생산 장비의 핵심부품 개발은 단기간에 이루어지기 어려운 동시에 관련 기업들이 보안을 강화한 프로젝트 형태로 진행되기 때문에 쉽게 노출이 되지 않고 개발성공 후 부품의 품질인증을 위한 기간이 최소 6개월~1년 이상이 소요되기 때문에 기술 진입장벽이 매우 높습니다. 이러한 기술적 진입장벽은 모방이 어려울 뿐 아니라 시간도 많이 소요되기 때문에 경쟁업체의 시장 진입은 불가능하다고 할 수 있습니다. 당사는 LCD 및 OLED 패널생산업체의 수공정에 핵심부품을 공급하고 있으며, 장비용 부품을 개발시 생산 공정의 엔지니어와 1:1 기술협력을 통한 맞춤형 핵심 부품 개발과 성능 개조 및 개선영역을 꾸준히 확대해 왔습니다.

또한 디스플레이 생산장비의 소모성 부품 역시 반도체 제조장비와 같이 지속적인 유지수요가 발생하고 있습니다. 따라서 당사 디스플레이 사업의 시장규모는 글로벌 디스플레이 전체 시장과 유사합니다. 가공생산량이 증가되면 패널 생산업체는 시장 수요에 대응하기 위한 신규 라인 증설과 기존라인 장비의 개조개선 투자를 하게 되고 신규장비투자(전체 투자비의 70% 차지)와 장비의 개조개선이 진행되어 다량의 신규 소모성부품이 필요하게 되는 특징이 있습니다. 자동차를 많이 운행하면 소모 부품의 교체주기가 짧아지는 것처럼 패널 생산량의 증가는 디스플레이 신규 장비 및 소모성 부품 시장이 확대되는 비례적인 특성이 있습니다.

반도체, 디스플레이 산업은 제품의 개발보다 공정기술 개발이 더 중요한 산업 중의 하나입니다. 공정기술의 차이는 생산수율의 차이로 이어지기 때문에 웨이퍼 한장에서 만들어내는 칩, 대형 패널을 효과적으로 양산하기 위해서는 공정기술의 확보가 매

우 중요합니다. 공정기술을 확보하기 위해서는 고품질 및 원가경쟁력을 갖춘 장비 및 소모성 부품을 사용하여야 하는데 이를 위해서 당사와 같은 정밀 가공 기술력을 갖춘 중소형업체가 주도적으로 고품질의 원가경쟁력을 갖춘 부품의 공급을 하여 삼성 전자, 삼성디스플레이, 엘지디스플레이 등의 고객사의 경쟁력 확보에 중요한 위치를 점하고 있습니다.

당사는 반도체, LCD 공정에 관련된 장비 및 검사장비등의 유사한 실적을 기반으로 축적된 기술력을 바탕으로 Mobile Display 용 Window 부착설비, 그리고 LED 칩 생산관련 장비 등을 연구 개발하여 양산하고 있어 설비의 국산화와 개조개선에 앞장서고 있습니다.

LCD 및 OLED 제조공정은 크게 CELL 공정과 MODULE 공정으로 나눌 수 있습니다. 당사의 MODULE 공정 장비는 LAMINATING(신기술공법) 공정에 집중화 하고 있습니다. MODULE 공정은 최근 시장과 소비자 요구에 인한 급격한 변화에 따라 신기술 합착 공정의 대두되면서 당사가 진입할 수 있는 틈새시장이 형성되게 되었으며 자체 선형 개발을 통한 기술적 노하우와 신규 기술력을 바탕으로 시장 진입이 가능하게 되었습니다.

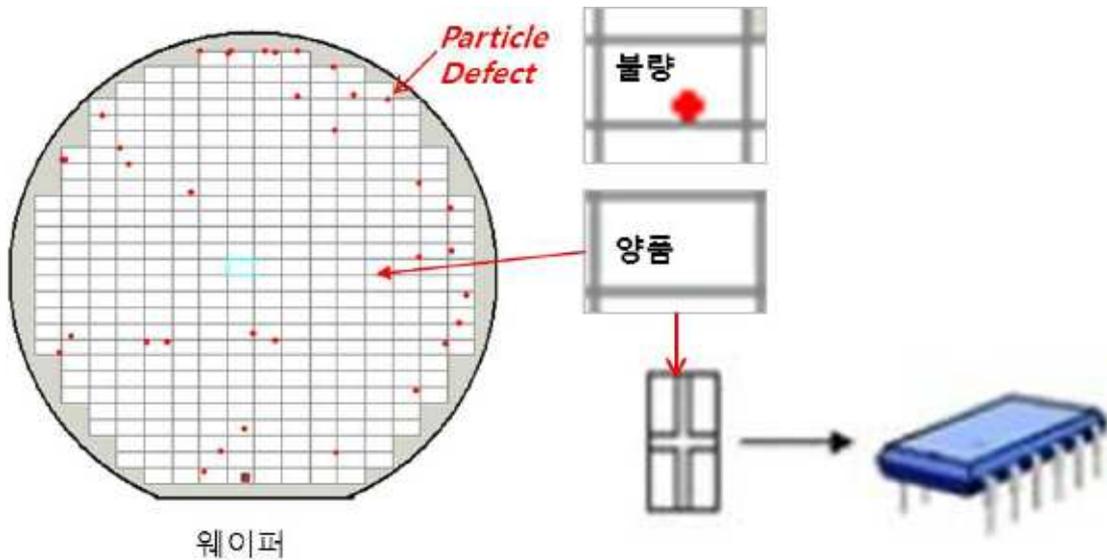
당사의 초기 장비 사업 단계는 검사 장비의 JIG 제작 등 기술적인 면보다는 당사의 정밀가공 및 설계 능력에 관련된 사업 부문으로 진행되었습니다. 이후 고객측 장비의 부품 국산화 및 장비 개조개선 활동을 통하여 독자적으로 공정장비를 생산 가능한 기술력을 보유하게 되었고, 2008년 MODULE 공정의 첫 양산 장비를 생산하게 되어 기술력에 대한 검증을 마쳤으며, 다양한 모델에 대한 수요에 맞추어 무안경 3D FILM 및 AMOLED Smart 기능 Module의 광학특성을 적용한 합착 등 고기능 시장에도 진입하고 있습니다.

2) 초정밀 세정 사업

반도체부품 세정 산업이란 생산과정에서 발생된 미세오염을 제어하는 산업으로써 단순히 반도체 장비나 부품의 오염을 제거하고 재생하는 것뿐만 아니라 부품특성조건 의 만족과 부품수명을 수십 회 또는 반영구적으로 사용 연장하는 한편, 나아가 반도체 공정효율과 생산수율의 증가를 목적으로 하는 산업분야를 말합니다.

반도체 부품 세정시장은 1997년 이후 원가절감의 일환으로 반도체 공정 장비 내에 조립되는 고가의 소모성부품들을 신규로 구입하여 교체하여 사용하던 것을 반도체 업체 자체적으로 세정하여 사용하기 시작하였으며, 최근 몇 년 사이 자체 세정하던 물량을 생산Capa 증대 등으로 전량 외주세정(당사가 진행하고 있는 형태의 세정)으로 전환하게 되었습니다. 2010년 이후 반도체 생산량을 증가를 위해 삼성전자 공정 내부에 세정공간을 없애고 생산공정 장비를 Set-up하면서 외주세정 의존도가 높아지고 있으며 이에 따른 외주세정시장이 성장하고 있습니다. 따라서 기존 자체 세정 물량을 전량 외주처리로 전환하게 되어 세정시장이 성장하고 있습니다. 반도체 세정 산업은 국내 반도체 소자업체 및 장비업체들의 지속적인 기술개발과 함께 원가 경쟁력 확보를 위한 노력을 기울이면서 원가절감의 일환으로 반도체 공정장비 내에 들어가는 고가의 소모성 부품들의 수명연장 및 부품국산화 사업을 1997년 IMF이후로 본격 시작하게 되었습니다. 2005년 이전까지는 반도체(고객사) 공장 내 자체 세정시설을 보유하고 있었으나 이후부터는 외주 전문세정업체에 100% 의존하여 부품을 세정 의뢰하고 있습니다. 반도체 생산 공정중에 발생하는 오염물은 제품의 수율을 떨어뜨리고, 부품 수명 단축과 제품의 품질을 떨어뜨리는 역할을 합니다.

[그림1] 미세 Particle(오염물질)로 인한 웨이퍼 불량 모드도



partic_세정

[그림 1]에서 보듯이 반도체 반도체 칩 제조 공정은 직경 200 ~ 300mm의 웨이퍼에 미세한 사이즈로 가공을 하게 됩니다. 따라서 웨이퍼 공정은 청정실이 필수적이며 제조 및 세정에도 초고순도 약품 및 가스, 초 순수를 사용 하여야 하며 파티클에 대한 이해가 필요합니다. 반도체 선폭은 머리카락(70 μm) 1/1000수준의 미세한 패턴을 가지고 있으며 공정 중 파티클이 한개라도 웨이퍼 패턴에 떨어지게 되면 해당 IC는 불량으로 사용할 수 없게되며, 이는 반도체 수율을 떨어뜨리는 결과를 초래하며 반도체 제조 공정에서는 사활을 걸고 파티클을 감소시키고자 전쟁을 하고 있습니다. 따라서 반도체 웨이퍼 공정에 사용되는 장비 부품은 반드시 일정 Lifetime이 지난 이후에는 세정을 하여 부품 외부에 흡착된 오염물(Contamination)을 제거하여야 하고 이를 통해 오염물이 웨이퍼 내부에 유입되지 않도록 차단하여야 합니다. 특히 반도체 Etch(식각) 공정에 사용되는 반도체 부품의 경우 수회의 반복공정, 고 플라즈마, 높은 전압 등의 가혹한 환경에 견뎌야 하는 특성으로, 반드시 표면 코팅의 작업이 필요합니다. 따라서 Anodizing, Quartz, Al₂O₃ 등의 소재가 사용하여 외부를 코팅하였고, 최근 고집적도의 반도체 공정이 되면서 내식성, 내플라즈마에우수한 Y₂O₃등의 코팅소재가 적용되고 있습니다.

당사는 이와 같은 반도체 수율과 밀접한 관련이 있는 미세 파티클의 제어 기술을 바탕으로 각 오염원의 선택적 제거가 가능한 화학물질 제어 능력을 바탕으로 삼성전자 반도체 등의 주요고객사에 납품을 하고 있습니다. 또한 당사는 반도체 부품 코팅에 특화된 기술력을 보유하여, 반도체의 부품 세정 이후 코팅을 동시에 진행하는 회사입니다. 부품가공의 경우 발생하는 오염물을 제거하는 목적으로 세정이 필수이나, 타사의 경우 가공사업과 세정사업을 함께 진행하는 업체가 없음으로 인해 발생하는 원가 상승을 자사는 해결함으로 타사 대비 단가/납기 단축의 경쟁력을 가지고 있습니다. 또한, 코팅 소재로 사용되는 이트리아는 희토류계열의 분말로 전 세계 생산에 95%을 중국에서 조달 공급하고 있습니다. 공급의 문제를 해결하기 위해 당사는 2008년에 한국세라믹기술원과 국책과제로 코팅용 분말의 제조 기술개발을 성공하여 원재료 수급 불균형 문제 해결 및 안정적인 공급가 확보를 통해 타사와의 단가 경쟁력에서 우위를 점하고 있습니다. 이와 같은 기술력과 원가경쟁력을 바탕으로 당사는 삼성전자 반도체 공정에서 발생하는 소모성 부품의 세정/코팅을 담당하고 있습니다.

3) 기타 사업부문

당사는 반도체 부품가공 및 세정, 코팅사업과 디스플레이 부품가공 사업을 주력으로 하고 있으며 주력 사업을 통해 다년간 축적된 정밀 가공 기술력과 영업 네트워크를 기반으로 신규 사업분야로의 진출을 활발히 하고 있습니다.

반도체 세정 및 코팅 사업으로부터 축적된 Chemistry 사업의 기술을 근간으로 하여 환경사업으로의 진출을 시도하였으며, 삼성전자와의 15년 이상 지속되어 온 우호적인 관계를 바탕으로 당시 삼성전자(주)LED사업부문의 공식 세일즈 파트너로 LED조명 및 LED소자사업에 진출하였습니다.

가) 환경사업부문

당사는 2009년 4월 환경사업부를 출범시켜 2010년 삼성모바일디스플레이사에서 요구하는 CAF를 개발 및 납품하기 시작하였으며, 2011년에 삼성모바일디스플레이사 신규 증설 라인에 대량 납품을 진행하기 시작하였습니다. 삼성 반도체 및 하이닉스 반도체에 CAF인증을 진행한 결과 삼성반도체에서는 Nikon 장비용 필터를 데모하여 정식 계약을 앞두고 있습니다. 하이닉스 반도체에 공급되는 공조용 CAF와 TEL(Tokyo Electronic Limit)사용 CAF를 인증 받았으며 현재 납품 진행 중에 있습니다.

반도체, 디스플레이 제조 크린룸에는 오염제어를 위한 환경기구로써 Air Filter를 사용합니다. Air Filter는 먼지(입자성 오염물질)를 제거하는 일반 Air Filter와 가스상 오염물질 및 냄새를 제거하고 Chemistry(화학적 성질)를 이용한 고집적화된 기술이 필요한 Chemical Air Filter(이하 'CAF')가 있습니다. CAF는 하나의 특정한 가스를 제거하기 위해 오염물질이 발생하는 공정에서 부분적으로 사용되어졌으나 현재는 크린룸 전체 및 다양한 산업분야로 확대되고 있을 뿐 아니라 제거대상인 Chemical Gas 또한 광범위하게 증가하는 추세이고 적용공정 또한 ① 크린룸 내부에서 순환되는 공기 중에 함유된 오염물질 제거용 ② 외부공기를 크린룸 내부로 유입하는 과정의 오염물질 제거용 ③ 생산 장비에 직접 설치하여 장비내부로 유입되는 오염물질 제거용 등 다양한 공정에 확대 적용되고 있습니다.

주1) Chemical Air Filter(CAF): 필터 내부에 오염물질을 제거할 수 있는 흡착소재를 포함

하여 공기 중에 포함되어 있는 유해 오염물질을 제거하는 제품으로써 당사의 핵심제품중 하나입니다.

나) LED 사업부문

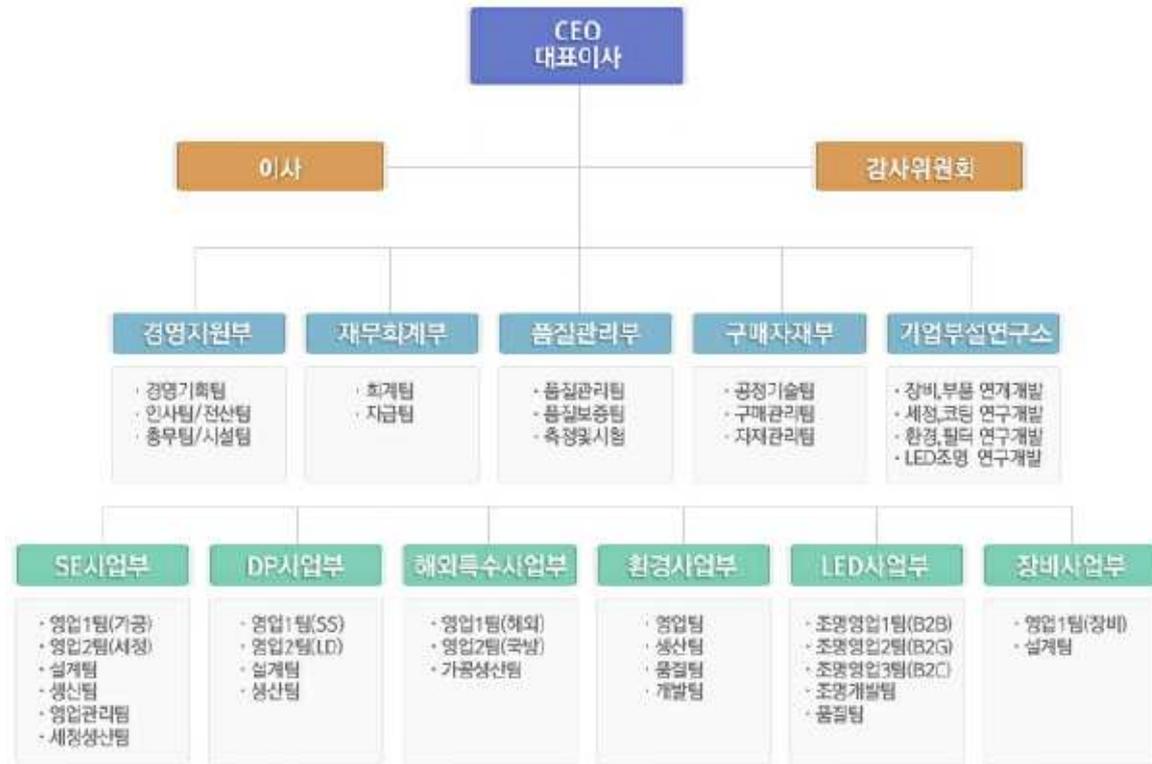
지금까지의 LED산업은 휴대폰, 컴퓨터, TV 등 BLU(Back Light Unit) 시장이 주도하고 있으나, 2012년부터 선진국들의 백열등 규제정책 시행과 가격인하로 LED조명 시장이 대중화되기 시작하였습니다. 이후 LED 산업은 高효율과 친환경적인 특징으로 미래 차세대 기술로 주목받고 있으며, 특히 일반 조명이 갖지 못하는 파장제어, 변조, 편광, 광색 가변 등 복합적 기능들을 고루 갖추고 있어 자동차, 환경, 의료, 교통, 농업, 생명, 정보통신에 이르기까지 '차세대 융합 산업'으로 재조명받고 있습니다.

당사가 참여하고 있는 LED 조명 시장은 LED 산업 중 가장 성장률이 높은 시장으로, 세계 LED 조명 시장은 연평균 45% 씩 성장하여 2015년 290억 달러, 2020년 1,015억 달러 시장으로 확대될 것으로 전망되고 있으며, 국내 시장도 2015년 36억 달러의 규모로 41.7%의 높은 연평균 성장률을 기록하면서 2018년에는 57억 달러 규모에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

LED산업은 다른 산업군에 비해 특허가 기업 경쟁력의 절대적 지표입니다. 원천 특허의 70%를 가지고 있는 니치아 및 오스람, 크리, 루미레즈, 도요다고세이등이 계속적으로 성장할 수 있었던 배경이 바로 특허블록을 형성했기 때문입니다.

국내업체로는 특허 및 생산 Capa에 가장 큰 강점을 가지고 있는 삼성전자(주)와 서울반도체(주)가 국내 LED소자 시장의 60% 이상을 점유하고 있습니다.

(2) 조직도



아이원스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ-1. 사업의 개요" 中 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 자본 변동표 · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) · 현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

제 10(당) 기 2013년 12월 31일 현재

제 9(전) 기 2013년 12월 31일 현재

과 목	제10(당기)		제 9(전기)	
자 산				
I.유동자산		21,087,991,958		28,946,918,737
1.현금및현금성자산	886,799,039		5,611,885,954	
2.당기손익인식금융자산	222,789,003		22,725,000	
3.재고자산	6,845,006,536		8,260,196,276	
4.매출채권및기타채권	10,059,724,494		1,145,536,168	
5.기타금융자산	2,214,471,945		3,004,279,344	
6.기타유동자산	859,200,941		596,295,995	
II.비유동자산		82,573,140,897		74,796,297,342
1.유형자산	76,266,838,801		69,473,399,521	
2.무형자산	1,172,463,809		781,855,317	
3.매도가능금융자산	100,000,000		100,000,000	
4.기타금융자산	4,923,152,423			
5.이연법인세자산	110,685,864		4,441,042,504	
자 산 총 계		103,661,132,855		103,743,216,079
부 채				
I.유동부채		27,163,337,143		37,692,586,254
1.매입채무및기타채무	10,029,072,625		9,641,019,688	
2.당기손익인식금융부채	102,542,545		458,150,543	
3.금융리스부채	852,800,679		2,171,539,619	
4.차입금	15,012,321,112		16,797,688,189	
5.당기법인세부채	787,650,590		1,210,442,652	
6.기타유동부채	378,949,592		7,413,745,563	
II.비유동부채		26,805,157,305		21,339,928,663
1.장기차입금	24,537,227,113		18,095,175,022	
2.금융리스부채			1,376,810,996	
3.이연법인세부채			565,921,821	
4.순확정급여부채	2,267,930,192		1,302,020,824	
부 채 총 계		53,968,494,448		59,032,514,917
자 본				
1.자본금	4,783,333,000		4,783,333,000	
2.기타불입자본	15,943,181,177		15,943,181,177	
3.이익잉여금	28,966,124,230		23,984,186,985	
자 본 총 계		49,692,638,407		44,710,701,162
부 채 및 자 본 총 계		103,661,132,855		103,743,216,079

- 손익 계산서(포괄손익계산서)

제 10(당) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

아이원스주식회사

(단위 : 원)

과 목	제10(당)기	제 9(전)기
I. 매출액	69,141,343,160	60,274,486,871
II. 매출원가	41,981,798,642	34,766,085,375
III. 매출총이익	27,159,544,518	25,508,401,496
판매비	659,101,006	16,249,942,131
일반관리비	20,838,982,015	
IV. 영업이익	5,661,461,497	9,258,459,365
기타영업외이익	4,167,830,420	904,819,369
기타영업외비용	2,158,184,743	939,182,885
금융수익	228,033,065	194,865,234
금융비용	1,381,657,196	1,270,814,581
V. 법인세비용차감전순이익	6,517,483,043	8,148,146,502
VI. 법인세비용	816,728,329	1,339,795,679
VII. 당기순이익	5,700,754,714	6,808,350,823
VIII. 기타포괄손익	(240,484,169)	25,914,304
확정급여제도의 재측정요소	(240,484,169)	25,914,304
IX 총포괄이익	5,460,270,545	6,834,265,127
X 주당이익		
기본주당이익	596	750
희석주당이익	596	750

- 자본변동표

제 10(당) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

아이원스주식회사

(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	총계
2013. 1. 1	3,151,760,000	4,652,977,000	17,149,921,858	24,954,658,858
유상증자	1,098,240,000	8,435,920,000		9,534,160,000
전환청구권행사	533,333,000	2,854,284,177		3,387,617,177
당기순이익			6,808,350,823	6,808,350,823
확정급여제도의 재측정요소			25,914,304	25,914,304
2013. 12. 31	4,783,333,000	15,943,181,177	23,984,186,985	44,710,701,162
2014. 1. 1	4,783,333,000	15,943,181,177	23,984,186,985	44,710,701,162
배당금지금			(478,333,300)	(478,333,300)

과목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	총계
당기순이익			5,700,754,714	5,700,754,714
확정급여제도의 재측정요소			(240,484,169)	(240,484,169)
2014. 12. 31	4,783,333,000	15,943,181,177	28,966,124,230	49,692,638,407

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 10 기 2014년 01월 01일부터
 2014년 12월 31일까지
처분예정일 2015년 3월 30일

제 9 기 2013년 01월 01일부터
 2013년 12월 31일까지
처분확정일 2014년 3월 28일

아이원스주식회사

(단위 : 원)

구분	제 10(당)기	제 9(전)기
I. 미처분이익잉여금	28,918,290,900	23,984,186,985
1. 전기이월이익잉여금	23,458,020,355	17,149,921,858
2. 당기순이익	5,700,754,714	6,808,350,823
3. 확정급여제도의 재측정요소	(240,484,169)	25,914,304
II. 이익잉여금처분액	(526,166,630)	(526,166,630)
1. 현금배당	478,333,300	478,333,300
2. 이익준비금	47,833,330	47,833,330
III. 차기이월미처분이익잉여금	28,392,124,270	23,458,020,355

- 현금흐름표

제 10(당) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 9(전) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

아이원스주식회사

(단위 : 원)

과목	제 10(당)기	제 9(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	11,464,664,856	14,118,452,347
(1) 당기순이익	5,700,754,714	6,808,350,823
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	12,504,382,749	10,562,728,804

과 목	제 10(당)기	제 9(전)기
감가상각비	5,793,282,872	5,139,027,553
퇴직급여	960,892,846	867,623,409
무형자산상각비	80,815,328	90,911,098
지급수수료	-	63,265,100
대손상각비	2,086,209,918	1,442,604,213
지급임차료	101,625,136	67,654,096
이자비용	1,381,657,196	1,270,814,581
외화환산손실	367,422,675	113,730,257
매도가능금융자산처분손실	24,662	-
파생상품평가손실	8,345,351	163,255,556
유형자산처분손실	-	3,202,462
매각예정자산처분손실	871,889,596	-
무형자산손상차손	35,488,840	-
법인세비용	816,728,329	1,339,795,679
잡손실	-	844,800
(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(3,495,330,132)	(472,045,849)
외화환산이익	196,625,891	246,908,392
이자수익	228,033,065	194,865,234
유형자산처분이익	60,890,330	7,547,223
매각예정자산처분이익	2,423,038,494	-
파생상품평가이익	586,742,352	22,725,000
(4)영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(244,375,687)	(901,045,835)
매출채권의 증가	(516,428,002)	(6,282,063,215)
선급금의 감소(증가)	(281,416,878)	25,401,357
선급비용의 증가	(20,377,427)	(14,633,805)
미수금의 감소(증가)	50,744,182	(499,176,961)
재고자산의 감소(증가)	1,415,189,740	(5,510,954,531)
매입채무의 증가	1,094,150,250	3,097,189,682
미지급금의 증가(감소)	(759,267,061)	2,290,273,817
미지급비용의 감소	(23,548,418)	(86,401,135)
선수금의 증가(감소)	(246,202,170)	362,452,880
예수금의 증가(감소)	(653,923,387)	6,835,417,327
부가세예수금의 감소	-	(75,132,258)
순확정급여부채의 증가	(303,296,516)	(998,448,400)
장기미지급금의 증가(감소)	-	(44,970,593)
(5)영업활동으로 인한 현금수취액	222,752,024	89,387,196
이자수익 수취	222,752,024	89,387,196
(6)영업활동으로 인한 현금지급액	(3,223,518,812)	(1,968,922,792)
이자비용 지급	1,375,219,605	1,193,537,423
법인세납부	1,848,299,207	775,385,369
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(17,394,067,098)	(26,020,365,588)

과 목	제 10(당)기	제 9(전)기
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	3,856,593,395	900,252,769
단기대여금의 회수	243,511,414	197,273,251
당기손익인식금융자산의 처분	22,725,000	-
단기금융상품의 감소	2,408,968,981	398,008,063
보증금의 회수	1,044,488,000	272,716,000
유형자산의 처분	136,900,000	32,255,455
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(21,250,660,493)	(26,920,618,357)
단기대여금의 증가	397,000,000	418,300,000
단기금융상품의 증가	710,044,958	948,664,648
장기금융상품의 증가	742,994,875	550,903,922
매도가능금융자산의 취득	24,662	-
보증금의 증가	1,647,430,000	781,706,000
유형자산의 취득	17,246,253,338	24,135,863,787
무형자산의 취득	506,912,660	85,180,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,216,076,222	15,098,719,647
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	29,751,351,991	43,069,544,902
단기차입금의 증가	20,313,851,991	17,255,384,902
장기차입금의 증가	9,437,500,000	16,280,000,000
유상증자	-	9,534,160,000
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(28,535,275,769)	(27,970,825,255)
단기차입금의 상환	24,311,540,180	20,871,949,740
유동성장기부채의 상환	1,000,000,000	1,738,000,000
유동성금융리스부채의 감소	2,615,402,289	2,090,875,515
장기차입금의 상환	130,000,000	3,270,000,000
배당금 지급	478,333,300	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(△+△△)	(4,713,326,020)	3,196,806,406
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	5,611,885,954	2,460,910,952
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(11,760,895)	(45,831,404)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	886,799,039	5,611,885,954

※ 기타 참고사항

위 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	배당금	시가배당율
제 9기	1주당 50원	0.8%

구분	배당금	시가배당율
제10기	1주당 50원	0.4%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명·생년월일·추천인·최대주주와의 관계·사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김병기	1972-04-28	부	특수관계인	이사회
총 (1) 명				

나. 후보자의 주된 직업·약력·당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
김병기	前 아이원스(주) 부 사장	옥션 기획팀장 브리앙파이브	있음

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2015년 3월 30일 개최될 제 10기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	6(3)	6(3)
보수총액 내지 최고한도액	10억원(이사보수총액)	11억원(이사보수총액)

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2015년 3월 30일 개최될 제 10기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.